

## Vishay发布高功率Power Metal Strip®电池分流电阻

Vishay发布高功率Power Metal Strip®电池分流电阻

Vishay Intertechnology, Inc. 推出新款采用带有4脚连接器的新款模塑外壳Power Metal Strip®电池分流电阻——WSBM8518。该器件使分流电阻到PCB的组装过程变得十分简单，让设计者专注开发电路，不必考虑PCB连接问题。

WSBM8518使用Vishay独家工艺技术，在8518封装尺寸内实现了36W的高功率和100 μΩ的极低阻值。能够提高燃气、柴油机、混合动力、电动汽车和卡车，以及电动叉车、载重卡车和其他重载工业应用的电池分流应用的精度。新电阻的容限为5.0%，提供更准确的数据来判定电池的充电和放电，帮助设计者满足特定用户对电池管理的要求。模塑外壳可简化设计，降低解决方案的总成本。



## 富士通半导体推出采用ARM Cortex-M4和M0+内核的32位微控制器系列产品

富士通半导体（上海）有限公司，推出其新的基于ARM® Cortex™M4处理器内核的FM4系列32位通用RISC微控制器，以及新的采用Cortex-M0+内核的FM0+系列。富士通计划在2013年提供这些新微控制器产品的批量样片，在年内晚些时候这些产品将全部投产。加上目前的FM3系列微控制器，采用Cortex-M4、M3和M0+处理器内核的产品组将有超过700款不同的产品。这些架构一致、使用灵活的产品将能够更广泛地满足用户对更高性能和更低功耗的日益增长的需求。



## 德州仪器推出面向云技术的第二代KeyStone多核SoC

德州仪器（TI）推出6款基于ARM Cortex-A15 MPcore处理器和TMS320C66x DSP内核的KeyStone II多核SoC。分别适用于云技术领域的专用服务器、企业和工业应用及电源网络。

除A15和C66x外，6款芯片还集成了安全处理器、数据包协处理器，及10G以太网交换协处理器。采用28nm工艺，工作频率800~1.4GHz，55c门户应用的功耗约6~13W。芯片特性如表1所示。用于专用服务器的KeyStone II多核SoC结构如图所示。电源网络应用中的KeyStone II多核SoC，采用直通加密安全处理进行数据包分类与路由选择，即网络信号可以通过以太网交换模块直接到安全协处理器、包协处理器进行处理，不需要CPU的参与。

